

四川省电子学会SMT/MPT专委会

川电会 SMT/MPT 专 【2024】 01

第二届电子制造可靠性技术应用研讨会

近年来，随着中国电子业逐步迈向高端制造，各行各业对质量工作日趋重视，以可靠性为中心的质量管理将是企业稳步发展的必然选择。电子部件是航空、航天、民用电子、汽车电子等产业的核心组成部分，电子材料、元器件、工艺的可靠性是实现高可靠电子部件的关键。四川省电子学会 SMT/MPT 专委会定于 2024 年 3 月 29 日在陕西省西安市召开“第二届电子制造可靠性技术应用研讨会”，针对市场需求与行业发展要求，从企业的生产实际出发，纯技术干货输出，帮助企业解决电子制造技术可靠性技术难题，为行业的健康发展搭建平台。会议现场还将同步举行电子制造行业新技术、新产品展示，热忱欢迎各位专家学者和企业代表积极参加。

一、会议主题

主题围绕航天/航空电子、消费电子、通讯互联、汽车电子制造可靠性提升与失效分析等重点问题进行研讨。从元器件选型设计到板级组装失效分析，提供全面可靠性问题解决方案，帮助企业在电子生产全流程中提升产品质量，促进电子制造行业持续健康发展。

二、会议组织机构

指导单位：四川省经济和信息化厅、四川省科学技术协会

主办单位：四川省电子学会

中兴通讯电子制造职业学院

五院西安分院（504 所）

中国电子科技集团第二十研究所

西安太乙电子有限公司

承办单位：四川省电子学会 SMT/MPT 专委会

协办单位：四川电子新工艺与新材料应用研究院

西南科技大学复杂环境装备可靠性研究中心

三、会议时间

2024 年 3 月 29 日（星期五），会期一天。

四、会议地点

陕西省西安市·西安钟楼亚朵 S 吴酒店千禧阁。



(2024. 3. 29) (西安)

3月29日		西安钟楼亚朵S吴酒店·千禧阁
	07:30-09:00	签到登记
	08:40-09:00	大会开幕式
A1	09:00-09:30	键合“弹坑”的失效分析方法研究 李扬 西安太乙电子有限公司(技术报告)
A2	09:30-10:10	CCGA器件组装工艺与焊点缺陷控制技术 任联锋 五院西安分院(504所)-制造中心副主任
A3	10:10-10:40	高可靠性电子焊接材料在微电子装联领域的应用研究 李爱良 中山翰华锡业有限公司-技术总监
	10:40-11:00	自助茶歇、参观展示、互动答题
A4	11:00-11:30	关于SMT多品种/小批量,特色生产模式探讨交流 邓超平 深圳松辉机电设备有限公司-运营总监
A5	11:30-12:00	高可靠产品清洗工艺及设备 吴民 南京电子技术研究所-高级工程师
	12:00-13:30	自助午餐、参观展示
A6	13:30-14:00	SPI在印刷系统中的管理及应用 马龙 成都熊猫电子科技有限公司-工艺总工
A7	14:00-14:30	射频连接器焊接面临的问题与方法思考 张飞 中国电子科技集团公司第二十研究所-电子装联/微组装负责人
A8	14:30-15:00	封装粘接用耐高温树脂体系及界面粘接问题的思考 刘长威-黑龙江省科学院石油化学研究院 研究员/博士
	15:00-15:20	自助茶歇、参观展示、互动答题
A9	15:20-15:50	精密电压调节器测试方法研究 崔文韬 西安太乙电子有限公司-高级工程师
A10	15:50-16:20	通讯产品新趋势下电子组装工艺可靠性面临的挑战 王世靖 中兴通讯股份有限公司-智造工程装联设计部-工艺研究资深专家
A11	16:20-17:00	如何开展板级产品焊点的可靠性分析 王豫明-清华大学SMT实验室-教授
	17:50-17:10	幸运抽奖